

2022年度学会賞

受賞者： 益 一哉（東京工業大学）

受賞理由：会長（2017年度～2018年度）として、当学会の発展、活性化及び運営に対しての貢献

益一哉氏は、エレクトロニクス実装学会において、2017年6月～2019年6月にかけて会長に就任し、当学会の発展及び運営に多大な貢献をした。特に、世界をリードする実装技術の牽引役と将来を担う若い技術者の育成に対する活動に力を入れた。また、会長退任後も継続的に学会の発展及び活性化への貢献を続けている。



氏は、東北大学、東京工業大学において、一貫して集積回路工学に係わる研究及び教育に携わってきた。東北大学においては、多層配線のための AI CVD 技術や低温動作 MOSFET の開発などに注力し、東京工業大学においては、高速・高周波 CMOS 集積回路の研究や CMOS-MEMS 超高感度慣性計測集積回路とその応用に関する研究に従事した。実装配線との接点となる多層配線技術においては、GHz 伝送線路配線技術に取り組んだ。CMOS-MEMS モノリシック異種機能集積技術によるナノ G センシングが可能な感染センサを開発し、パーキンソン病の早期診断技術へ応用するなど出口指向の研究展開にも取り組んだ。これらの成果は、電子情報通信学会業績賞（2013年）、電気学会業績賞（2014年）として高く評価されている。共に研究に取り組んだ多くの卒業生や教員は学界、産業界において広く活躍しており人材育成にも貢献した。

NEDO「立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発（2008年～2012年）」ではプロジェクトリーダーを務め、このプロジェクトを通じて開発された数々の成果は、現在の三次元集積回路技術の基盤へと繋がっている。

応用物理学会フェロー（2009年）、電気学会フェロー（2011年）、電子情報通信学会フェロー（2015年）、応用物理学会副会長（2014・15年）など学会での幅広い活動と経験は、本学会理事（2013年・14年）、会長（2017年・18年）においても活かされ、本学会が他学会との協業を推進する基盤を築いた。

現在は、東京工業大学学長を務めるとともに、経済産業省産業構造審議会「グリーンイノベーションプロジェクト部会」部会長を務めるなどエレクトロニクス技術のカーボンニュートラルへの展開にも高い視座から貢献している。

このように、エレクトロニクス実装技術分野における技術開発のみならず人材育成、永年に亘る

取り組みを通してのエレクトロニクス実装学会及びエレクトロニクス業界に対する貢献は極めて大きく、益 一哉氏に学会賞を贈呈する。

[主な論文など]

- (1) K. Masu, K. Tsubouchi, N. Shigeeda, T. Matano and N. Mikoshiba, "Selective Deposition of Aluminum from Selectively Excited Metalorganic Source by the rf Plasma", Appl. Phys. Lett., 56(16), 1543-1545, 1990.
- (2) M. Yokoyama, T. Hidaka, K. Sasaki, K. Masu and K. Tsubouchi, "Short-Channel-Effect Free 0.18 μ m MOSFET by Temperature-Dimension Combination Scaling Theory: Design and Experiment", IEEE Electron Device Lett., 15(6), 202-205, 1994.
- (3) H. Ito, M. Kimura, K. Miyashita, T. Ishii, K. Okada, and K. Masu, "A Bidirectional- and Multi-Drop-Transmission-Line Interconnect for Multipoint-to-Multipoint On-Chip Communications", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 43, No. 4, pp. 1020-1029, 2008.
- (4) M. Imai, T. Sato, N. Nakayama, and K. Masu, "Non-Parametric Statistical Static Timing Analysis: An SSTA Framework for Arbitrary Distribution", 45th Design Automation Conference (DAC), pp. 698-701, Anaheim, June 2008.
- (5) A. Shirane, Y. Fang, H. Tan, T. Ibe, H. Ito, N. Ishihara, and K. Masu, "RF-Powered Transceiver With an Energy and Spectral-Efficient IF-Based Quadrature Backscattering Transmitter", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 50, No. 12, pp. 2975-2987, Dec. 2015.
- (6) K. Masu, K. Machida, D. Yamane, H. Ito, N. Ishihara, T. M. Chang, M. Sone, R. Shigeyama, T. Ogata and Y. Miyake, "CMOS-MEMS Based Microgravity Sensor and Its Application", ECS Transactions, vol. 97, no. 5, pp. 91-108, April 2020. DOI: <https://doi.org/10.1149/09705.0091ecst>
- (7) 益 一哉、"大学イノベーション創出論－東工大発・未来社会 DESIGN の挑戦"、日経 BP コンサルティング、2020年3月
- (8) 益 一哉、天川修平、"電子物性とデバイス"、電子情報通信レクチャーシリーズ A-9、コロナ社、2020年11月

[略歴]

1975年・神戸市立工業高等専門学校 電気工学科 卒業

1982年・東京工業大学 大学院理工学研究科電子工学専攻 博士後期課程修了（工学博士）

1982年・東北大学 電気通信研究所 助手

2000年・東京工業大学 精密工学研究所 教授

2016年・東京工業大学 科学技術創成研究院 研究院長

2018年・東京工業大学 学長 現在に至る

内閣官房・教育未来創造会議 委員（2021年12月～）

経済産業省・産業構造審議会・グリーンイノベーションプロジェクト部会 部会長（2021年2月～）

2021 年度功績賞

受賞者：小岩一郎（関東学院大学 教授）

受賞理由：学会活動と部品内蔵基板の国際標準化への貢献

小岩 一郎氏は、エレクトロニクス実装学会の前身である、プリント回路学会で 1990 年度に論文賞を受賞している。関東学院大学に異動されてから、配線板製造技術下に発足した EPADs 研究会の主査を担務され、同研究会が部品内蔵技術委員会に昇格した際も、初代委員長を担務され以後 6 年間に渡り、同技術の啓蒙活動に尽力されてこられた。現在も同委員会下の三次元電子回路実装研究会の主査として、部品内蔵技術の更なる発展に向け活発に活動を牽引されている。また、2008 年度にエレクトロニクス実装学会論文賞を受賞している。



さらに、2012 年には当学会の副会長として様々な運営課題に精力的に取り組み、今日に至る健全経営に貢献された。

2008 年からは、JPCA 部品内蔵標準化委員会の副委員長に就任し、その後、委員長に就任、当該技術の標準化に注力された。当時は、「標準化は整理のためのもの」という認識が多く、「新しい技術を戦略的に世界標準化する」という発想は少なかった。ヨーロッパにより主導されている世界標準を、将来有望な部品内蔵基板で日本が優位に立てるように、戦略的な世界標準の作成を目指した。その結果、日本初となる IEC 規格の元を作られた。この後継活動として JPCA 統合規格部会の主査を担務され、IEC 規格、JIS 規格、IPC 規格に於ける電子回路基板規格の統合刷新を行い、JPCA 統合規格として発行に寄与された。

2019 年には特許庁の令和元年度特許出願動向調査「電子部品内蔵基板」委員会の委員長を務められ、世界の部品内蔵技術に関する知財及び学術論文の調査を行われ、当該技術の普及発展に向け極めて重要な取り組をされた。

展示事業委員会にて、JPCA ショー時に併催される当学会主催のアカデミックプラザの創立、運営に多大なる尽力をされ、10 年連続発表をして表彰されている。さらに、現在も精力的に推進頂いている。

略歴：

- 1987 年 早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程 応用化学専攻 工業物理化学研究修了（工学博士）
- 1986 年 早稲田大学 理工学部 助手 採用
- 1988 年 沖電気工業株式会社入社 主に研究開発に従事
その後、早稲田大学 各務記念材料技術研究所 客員助教授（非常勤）
早稲田大学 総合理工学研究センター 客員助教授（非常勤）
- 2005 年 早稲田大学 総合理工学研究センター 客員教授（非常勤）
- 2005 年 関東学院大学工学部物質生命科学科教授として採用
関東学院大学理工学部理工学科化学学系教授 就任 現在に至る
2018 年度ドイツ アーヘン大学客員教授

2021 年度功労賞

受賞者:藤原 裕 (元)大阪産業技術研究所)

授賞理由:各種めっき技術とエレクトロニクス実装技術に関する長年の貢献

藤原裕氏は、1978 年より約 40 年間にわたって、大阪市立工業研究所(現 大阪産業技術研究所)において、めっき技術の研究開発および企業への技術支援に従事し、めっき技術の発展に大いに貢献した。研究分野は、合金めっき、複合めっき、無電解めっきなど、産業利用が図られるめっき技術を網羅するものである。特に、プロセスからの環境負荷の低減およびエレクトロニクス実装技術への応用を軸に据えた実用技術の開発に邁進し、鉛フリーはんだに対応したスズ/銀ナノ粒子複合めっき、プリント配線板用無電解銅めっきのためのパラジウムフリー銀ナノ粒子触媒、シアンフリー浴からの装飾用銅-亜鉛合金めっき、六価クロムフリー防食表面処理プロセス、無電解スズめっきによるリチウムイオン電池負極材料、などの顕著な開発成果を上げ、その多くは産業利用された。



現在、ISO TC107 国内委員長として金属・無機コーティング技術の国際標準の策定に携わり、また電波透過 PVD 膜、電磁波シールドめっき膜などの新しい技術の標準化を進めている。

エレクトロニクス実装学会においては、延べ 3 期 6 年間、理事および常任理事として学会の運営・発展に尽力するとともに、MES 論文委員長としてシンポジウムの活性化・質の向上に貢献した。また、関西支部においては、設立当初からのメンバーとして、副支部長、監査などを歴任し、支部活動の活性化に貢献した。

略歴

1978 年 京都大学大学院 理学研究科 博士前期課程修了

1978 年～2019 年 大阪市立工業研究所 (現 (地独)大阪産業技術研究所) 勤務

2013 年～2019 年 奈良先端科学技術大学院大学 客員教授 兼務

現在 ISO TC107(金属・無機コーティング専門委員会) 日本国内委員会委員長

大阪府鍍金工業組合 顧問

博士(工学)

2021 年度功労賞

受賞者:若林 猛(株式会社エイチ・ティー・エル)

授賞理由:部品内蔵技術および

銅ポスト封止型ウェハレベルパッケージ技術開発に関する長年の貢献

若林猛氏は、カシオ計算機入社以来、半導体プロセス技術に従事し 1987 年からは、半導体小型実装に関わるウェハバンプ技術開発とその量産化事業にも貢献し、国内外の半導体、エレクトロニクス関連企業の製品開発を実現させた。そして、これらの技術開発や量産化に伴う新規材料、設備開発にも積極的に取り組み、業界全体の発展にも大きく寄与した。

その後、沖電気工業と共同で、このウェハバンプ関連技術を進化させた、「銅ポスト封止型ウェハレベルパッケージ」を開発し、2001 年から量産化と製品適用も実現した。この技術の特徴となっている封止構造により、チップの保護、実装信頼性が向上し、当時、他の技術では対応できていなかった、端子数が多く大きなサイズのチップへの適用が可能となった。そして、携帯電話で使用される半導体デバイスでのウェハレベル対応が急速に進み、その後のスマートフォンの高機能化実現や、この技術領域が究極の半導体パッケージとして、大きく発展することにつながった。

また、はんだボールを搭載しない形態で基板に内蔵し、プリント配線板の従来のプロセスをそのまま適用してビアめっき接続実装をする「半導体の部品内蔵」に対して、銅ポスト封止構造が適していることから、日本シイエムケイと共同で部品内蔵技術開発を実施し、実際のエレクトロニクス製品への適用も初めて成功させた。そして、業界での部品内蔵への取り組みを活性化するために、EWLP コンソーシアムの活動なども実施し、その後、部品内蔵技術委員会へも引き継がれている。

カシオ計算機での実装技術からウェハバンプ、ウェハレベルパッケージ、部品内蔵など広範囲な領域で長年、エレクトロニクス実装学会での活動では、技術講演、委員会での活動などに参加し貢献しており、今後は、低抵抗接続、高放熱のための薄型絶縁、高耐熱、高信頼性が重要なパワー半導体モジュール分野への部品内蔵技術の本格適用に対しても取り組みを期待している。



略歴

1980 年 千葉大学理学部物理学科卒、同年カシオ計算機株式会社に入社

(1999-2001 年 IEP テクノロジーズ)

2009 年 カシオマイクロニクス株式会社

2011年 株式会社テラミクロス

2013年 株式会社エイチ・ティー・エル

2021年度マイスター賞

受賞者:宗像寿美 (パナソニック インダストリー株式会社)

受賞理由:「多層基板材料「MEGTRON」の製造技術」

宗像寿美氏は、当社入社以来、一貫して製造部門に所属し、多層基板材料「MEGTRON」の製造安定化の礎を築き、長年当社の販売に大きく貢献してきた。



MEGTRON は、当社低伝送損失多層基板材料を代表する商品であり、現在でも ICT 分野を中心に広く使用され高速通信分野の発展に貢献している。MEGTRON で用いられる樹脂系は、従来の多層基板材料とは全く異なることから、製造設備の変更や製造条件の再設定が必要であったが、同氏は製造設備メーカーや原材料メーカー、社内関係者との協働により様々な課題を克服、また主な需要地である海外拠点への水平展開により、海外での MEGTRON の立上げ～地産地消を基軸とした生産・供給体制の構築にも大きく貢献した。

一般的に低伝送損失多層基板材料は、低誘電率設計に由来して静電気を帯びやすい性質を伴っており、製造工程における異物管理と対策が非常に重要である。こうした異物管理に対しても、様々な帯電防止策の実施だけでなく、CCD カメラやインライン計測器の充実と品質工学的手法に基づいた工程内異物管理の強化と標準化をグローバルに推し進めることで、MEGTRON の安定生産体制を樹立した。

現在も、製造責任者として安定品質の維持、MEGTRON 対応のモノづくり革新に継続して取り組んでおり、今後見込まれる製造プロセスの自動化や DX の推進に関しても積極的に新技術を取り入れ、グローバルでの安定品質のモノづくりに貢献し続けている。

経歴

1981年 福島県立郡山北工業高等学校 卒業

同年 松下電工株式会社 電子基材事業部 郡山工場 入社
MEGTRON 製造立上げ、海外展開、品質改善に従事

2000年 松下電工電子材料 広州工場立上げ

2001年 松下電工株式会社 郡山電子基材商品部 西工場立上げ

2006年 パナソニック電工株式会社 蘇州工場立上げ

現職 パナソニック インダストリー株式会社 電子基材ビジネスユニットにて MEGTRON 生産、販売拡大に従事

2021 年度論文賞

1. 「コーティング処理した電子部品の硫化腐食寿命の推定技術の開発」

南谷 林太郎, 高山 悦寛, 水谷 英司, 高橋 亮, 出野 徹哉
(株式会社日立製作所、)

搭載電子部品の硫化腐食挙動はコーティング膜の硫黄ガス透過性に依存することを明らかにし、コーティング膜のガス透過試験法、硫化腐食寿命の推定法を確立した。また設計寿命を満足するコーティング膜厚を求める防食設計線図を作成、今後活用可能。電子部品実装におけるモジュール全般に波及可能な研究成果である。以上の観点より論文賞として推薦いたしたく思います。

2. 「消防活動支援システムにおける 中継器用人工磁気導体一体型アンテナに関する検討」

井熊 雄介, 柳田 信也, 水野 雅之, 大宮 喜文, 山本 隆彦
(東京理科大学)

消防隊員の体温や心拍数などのデータをリアルタイムで把握することで、業務中の熱中症発症を未然防止する活動支援システムが検討されている。火災現場の通信環境は障害物が多く、中継器による通信距離や通信品質の改善が想定される。中継器用アンテナは、単一指向性で設置場所の背部状況に依存しない性能が求められる。

本論文では、中継器用アンテナとして、人工磁気導体(AMC)一体型アンテナを提案し、試作評価を実施している。放射指向性について AMC 併用によるアンテナ利得や F/B 比の向上を確認し、新規性と独創性が高い。また、近傍に金属板が存在する場合でもアンテナ利得の劣化を低減可能であることを確認し、有用性が高く、論文賞に推薦する。

— 論 文 賞 —

「コーティング処理した電子部品の硫化腐食寿命の推定技術の開発」

南谷 林太郎, 高山 悦寛, 水谷 英司, 高橋 亮, 出野 徹哉

(株式会社日立製作所)



南谷 林太郎

1986年 東京理科大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻 修士課程修了。同年 (株)日立製作所入社。現在、同社 研究開発グループに所属、主に電子機器・部品の腐食防食研究に従事。博士(工学)、エレクトロニクス実装学会、腐食防食学会、材料学会会員。



高山 悦寛

1995年 宮城県工業高等学校電気科卒業。同年、(株)日立製作所 水戸工場入社。現在、同社、鉄道ビジネスユニットに所属、入社以来一貫して鉄道向け制御装置の設計業務に従事。



水谷 英司

2001年 上智大学大学院 理工学研究科 機械工学専攻 博士前期課程修了。同年(株)日立製作所入社。現在、同社 鉄道ビジネスユニットに所属、主に鉄道信号保安システムの設計開発に従事。技術士(電気電子部門)、電気学会会員。



高橋 亮

2003年 東京工業大学 総合理工学研究科 物質科学創造専攻修士課程修了。同年、株式会社日立製作所入社。現在、同社サービス&プラットフォームビジネスユニット所属。主にプリント板生産ラインの生産技術開発に従事。



出野 徹哉

日立製作所 デジタルシステム&サービス統括本部 品質保証統括本部 制御プラットフォーム品質保証本部 品質保証第一部 部品品質保証グループ 所属。現在、購入品の品質保証業務に従事。

— 論文賞 —

「消防活動支援システムにおける 中継器用人工磁気導体一体型アンテナに関する検討」

井熊 雄介, 柳田 信也, 水野 雅之, 大宮 喜文, 山本 隆彦
(東京理科大学)



井熊 雄介

1998 年 生まれ
2024 年 東京理科大学大学院理
工学研究科電気工学専攻修士課
程修了
現在、日本電気株式会社



柳田 信也

1978 年 生まれ
2007 年 東京都立大学大学院理
学研究科博士課程修了
現在、東京理科大学教養教育研
究院野田キャンパス教養部教
授。



水野 雅之

1975 年 生まれ
2003 年 東京理科大学大学院
理工学研究科建築学専攻博士
後期課程修了。
現在、東京理科大学大学院理
工学研究科国際火災科学専攻
准教授。



大宮 喜文

1967 年 生まれ
1996 年 東京理科大学大学院
理工学研究科建築学専攻博士
後期課程修了。
現在、京理科大学工学部建
築学科 教授。



山本 隆彦

1980 年 生まれ
2009 年 東京理科大学大学院
理工学研究科電気工学専攻博
士後期課程修了。
現在、東京理科大学工学部
電気電子情報工学科 准教授。

2020 年度技術賞

1. 「導電性ペーストを用いた一括積層による Any Layer 基板技術の開発」

飯田憲司、酒井 泰治 (FICT 株式会社)

従来のめっきによる IVH 構造を組み合わせた基板工法に代わり、熔融型導電性ペーストを用いた一括積層プロセスによる Any Layer IVH 構造の F-ALCS (F-All Layer Z-Connection Structure) 基板技術を開発した。本工法により、従来比 2 倍以上の配線収容能力を確保することで、設計自由度を大幅に高めることができ、これにより不要なエリアを削減してシステムボードにおける実装高密度化に貢献した。また、従来の導電性ペーストでは、信頼性試験における抵抗値の変動が課題となっていたが、F-ALCS 開発にあたり抵抗値変動を抑制できる導電性ペーストを見出し、それを用いたプロセス技術を確立することで 60 層以上の高多層化と高信頼化を同時に実現した。さらに、導電性ペーストを用いた印刷による製造プロセスのため、従来のメッキによる製造プロセスと比較してプロセスステップを簡略でき、二酸化炭素排出量を約 40%削減することが可能となるため、SDGs にも貢献できる技術であると考えられる。開発した F-ALCS 技術について複数製品へ適用し、現在も量産製造中である。

従来から導電性ペーストの IVH を用いた基板技術はあるが、高多層でも抵抗変動が極めて低い導電性ペーストを IVH に適用、汎用プリプレグによる積層基板を実現した点に技術的な優位性がある。さらに Any Layer IVH 構造によるスタブレス化による高速伝送での利点、また、めっき液不要の VIA 形成技術など環境負荷の観点でも大きな優位性がある。製品化も実現して量産展開中であり、今後も高周波での伝送特性が要求される 5G/ Beyond 5G 向けのネットワーク機器や高性能サーバ向け高多層基板での量産適用が将来に渡って期待される技術と考える。

2. 「5G通信の普及を支える活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の開発」

有田和郎、鈴木悦子、下野智弘、岡本竜也、出村智、山田雅生、藤本恒一 (DIC 株式会社)

近年、スマートフォンやタブレット端末に代表される電子製品は、クラウド化による高性能サーバの登場など目覚ましい進歩を遂げている。これらの電子製品には、従来からエポキシ樹脂を使用したプリント配線基板が用いられてきたが、高度情報化社会では、膨大な情報を高速に処理、伝達する技術が重要であり、伝送損失の観点から、硬化物中に水酸基を多く含むエポキシ樹脂の使用には限界があると言われていた。一方で、エポキシ樹脂は、優れた硬化性・密着性と高耐熱性を両立できることや、ガラス転移温度以上の温度領域(ゴム状領域)で優れた物性保持力を有していることなどを鑑みると、高耐熱性エポキシ樹脂の工業的価値は非常に高く、これに代わる一般材料は見出されていないのが現状であった。

活性エステル基を有する化合物は、エポキシ樹脂と反応する際、エステル基の転位反応により、実質的に硬化反応による水酸基の生成がないため、大幅な誘電率・誘電正接の低減が

可能となる。これらは活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤と呼ばれ、1991年に西久保先生らから発表されていたが、市場には存在しないものであった。エレクトロニクス実装材料に対応できる耐久性や硬化性、耐熱性等の性能面、製造方法や溶剤溶解性等の工業化や実用化面で様々な課題を解決できずにいたからである。

本技術において開発された新規な活性エステル型硬化剤は、工業的に汎用な有機溶媒（MEK、トルエン等）への溶解性に優れることから、従来の樹脂ワニス化からプリプレグ製造、プレス工程などプリント配線基板製造のプロセスにおいても、現在一般的に使用されているエポキシフェノール樹脂硬化システムの設備から全く条件を変更することなく、同一ラインでの生産が可能であり、特殊な硬化系であるにも拘らず、設備投資なく高付加価値のプリント配線基板の製造を実現させた。更には硬化物の特性としての高耐熱性、低吸湿性など優れた物性をも兼備する革新的な新材料技術である。この技術により、エポキシ樹脂組成物では、これまで達成困難と考えられていた高周波対応プリント基板にも採用が始まり、高速通信規格 5G の普及を加速させ、テレワークに代表される With コロナの世界を支えるに至っている。時代の変化を先読みし、アカデミア発信の要素技術の課題を 10 年もの期間諦めずに検討した結果、実用化に成功した本新材料技術は、あらゆる実装部品へ展開可能な基盤技術であり、エレクトロニクス産業への大きな貢献が期待される。

— 技 術 賞 —

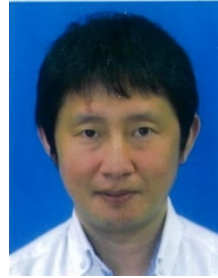
1. 「導電性ペーストを用いた一括積層による Any Layer 基板技術の開発」

飯田憲司、 酒井 泰治 (FICT 株式会社)



飯田 憲司

昭和 43 年生まれ
平成 2 年 福岡工業大学 電
子機械工学科卒
現在、FICT 株式会社 開発
グループ 先行技術開発部



酒井 泰治

昭和 52 年生まれ
平成 14 年 大阪大学工学研
究科修士課程修了
現在、FICT 株式会社 開発
グループ 先行技術開発部

— 技術賞 —

「5G通信の普及を支える活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の開発」

有田和郎, 鈴木悦子, 下野智弘, 岡本竜也, 出村智, 山田雅生, 藤本恒一 (DIC 株式会社)



有田 和郎

1994年:大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC 株式会社)入社。電子材料向け素材開発およびそれらの製造プロセス開発に従事。
2015年:博士(工学)取得(横浜国立大学工学府)。
2016年:R&D部門にてネットワークポリマー全般の研究開発に従事,現在に至る。



鈴木 悦子

1994年:大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC 株式会社)入社。
2000年:電子材料向け素材開発に従事。
2016年:R&D部門にてネットワークポリマー全般の研究開発に従事,現在に至る。



下野 智弘

2008年:東京工業大学大学院理工学研究科応用化学専攻修士課程修了。
同年:DIC 株式会社入社。
現在:電子材料向け素材開発に従事



岡本 竜也

2012年:東京工業大学大学院理工学研究科応用化学専攻修士課程修了。
同年:DIC 株式会社入社。
現在:電子材料向け素材開発に従事。



出村 智

1988年:東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了。
同年:大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC 株式会社)入社。
主に高周波通信用絶縁材料やデジタル印刷材料とそれらの製造プロセスの開発に従事。
現在:カラー技術本部に所属。



山田 雅生

1986年:東京工業大学大学院工学部工学研究科修士課程修了。
同年:大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC 株式会社)入社。
主に高分子ファインケミカル製品の製造プロセス開発に従事。
現在:機能性材料技術本部に所属。



藤本 恒一

1991年:九州工業大学大学院工学研究科物質工学専攻修士課程修了。
同年:大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC 株式会社)入社。
エポキシ樹脂及び関連製品の開発業務に従事。
現在:化学品情報技術グループにてEH&S関連業務を担当。